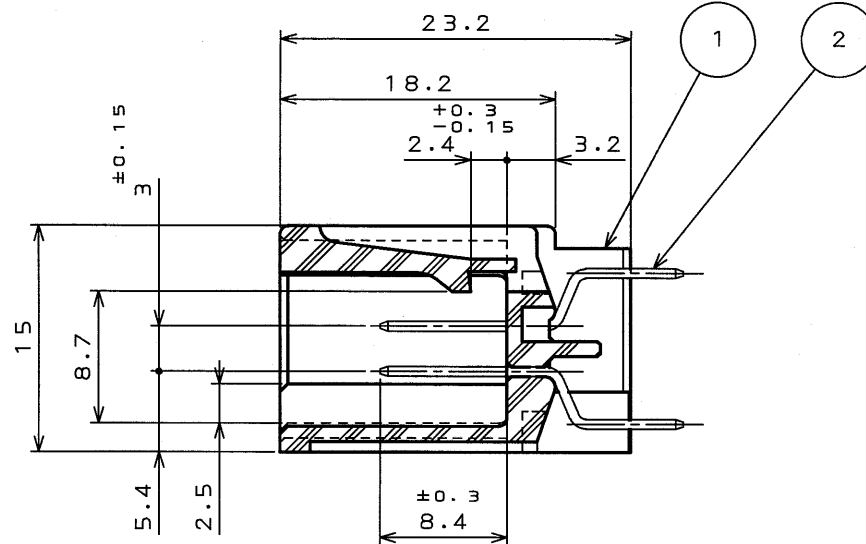
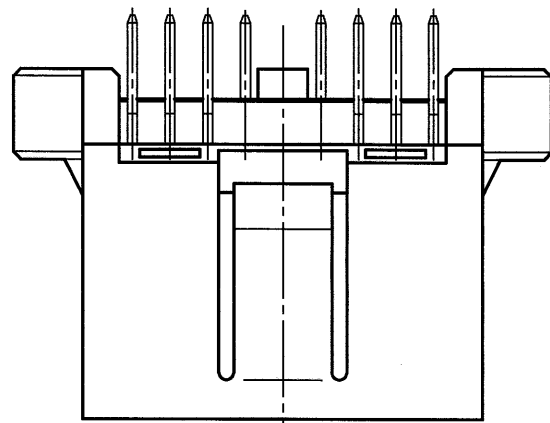
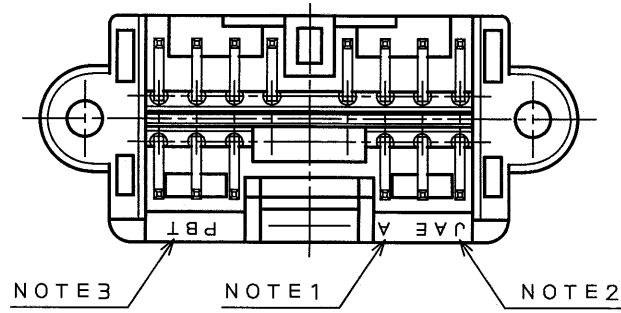


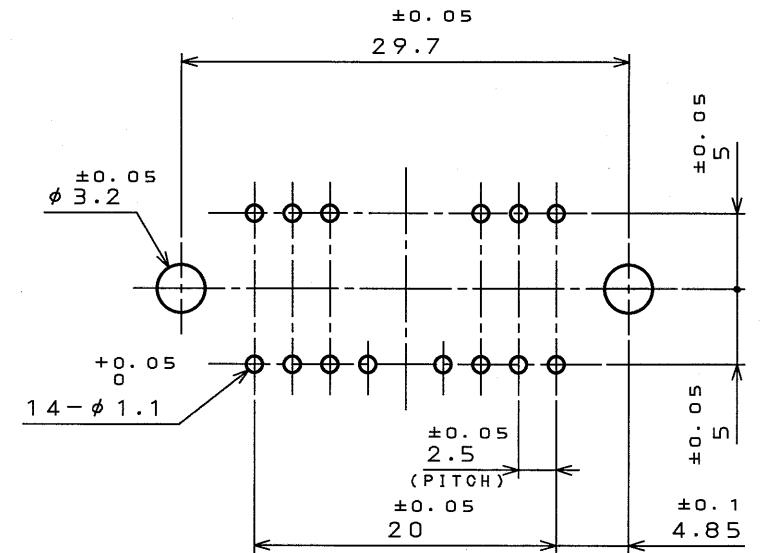
8509E01S

(DRAWING NO.) 台票图

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



SECT. A-A

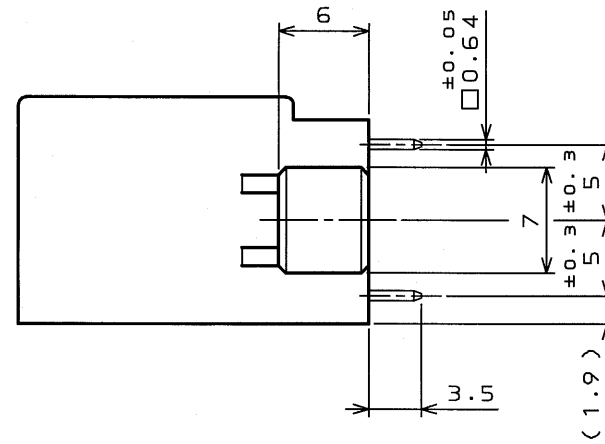
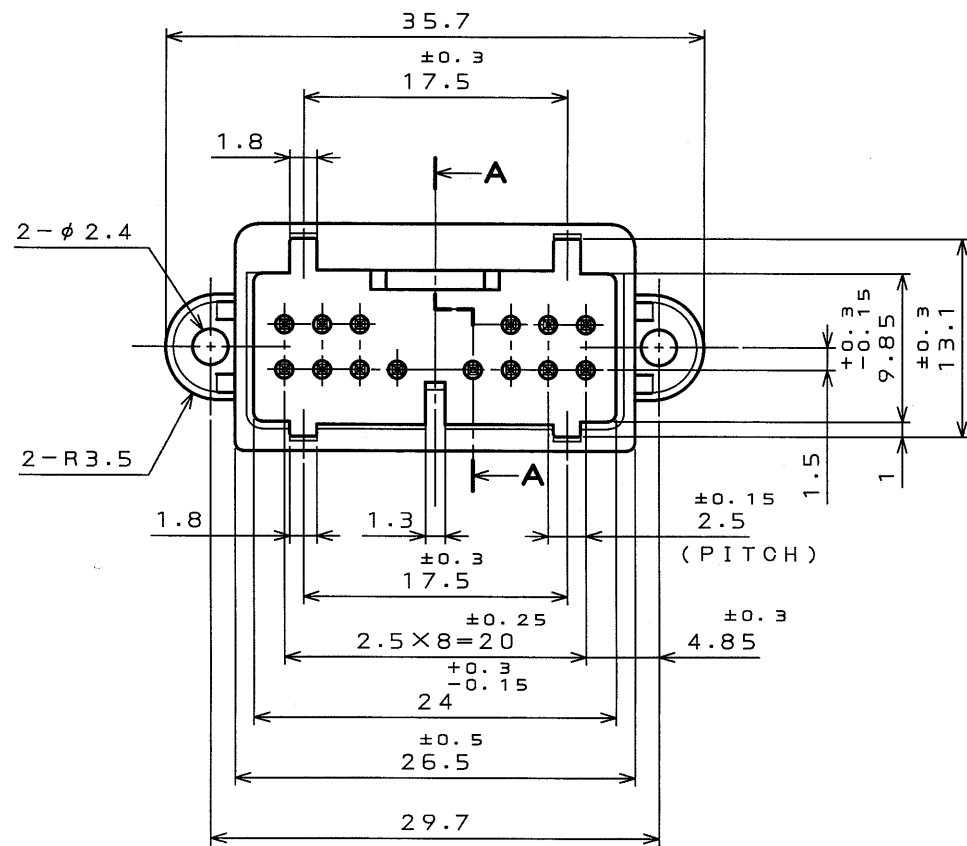


APPLICABLE P.C.B. DIMENTION.(REF.)

基板取付寸法(参考)

THICKNESS t1.6

基板厚 t1.6



- NOTE1. EMBOSS CAVITY DESIGNATOR.
 2. EMBOSS COMPANY LOGO DESIGNATOR.
 3. EMBOSS MATERIAL LETTERS.
 4. NO PLATING ON THE CHAMFERED ENDS CONTACT.
- 注1. 金型マークを浮き出す。
 2. 社標を浮き出す。
 3. 材料マークを浮き出す。
 4. コンタクト先端部に、メッキは付かない。

2 CONTACT	14 BRASS	TIN PLATING	
1 INSULATOR	1 PBT		COLOR: GREEN
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL
仕様書(SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE) 21.Jun.2001	仕上げ FINISH	備考 REMARKS
JACS-1309	製図 DR. T.NAKAYA	2:1	IL-AG7
公差(GENERAL TOLERANCE)	担当 CHK. K.HASEBE	名称(TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法(DIMENSION)	査閲 APPD. M.WATANABE	IL-AG7-14P-D3T2	
角度(ANGLES)	承認 APPD. Y.ICHIIYAMA	重量(WEIGHT)	
. ±0.8 .X ±0.5 .XX ± .XXX ±	X° ± X°X' ±		
			図面番号(DRAWING NO.) SJ036058
			版数 (REV.) 1